

信息披露

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已按相关法规规定在本报告书中详细描述了公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本公司“第三节 管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

4 公司年度报告经董事会议通过。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元(含税)。以目前总股本数计算,合计拟派发现金红利人民币40,800,000.00元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.01%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

8 公司2021年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过及第一届监事会第十二次会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

9 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 □不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票概况

□适用 □不适用

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所科创板	恒玄科技	689008

公司存托凭证简况	
联系人和联系方式	董秘秘书(信息披露境内代表)
姓名	李广平
办公地址	上海市浦东新区金科路2889号长泰广场 B座 10层
电话	021-68771798/6966
电子邮箱	ir@hitechinc.com

2 报告期内公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务分为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Wi-Fi智能音箱、智能手环等低功耗智能音频终端产品。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卓手机品牌,同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌的客户深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要构成包括设计、制造和封测环节,属于资本与技术密集型行业。我国自2000年起便开始实施相关政策文件,从产业规划、财税政策、资金引入等多个方面鼓励集成电路行业的发展,发展集成电路设计行业被写入国家五年发展规划及政府工作报告中,体现出国家对该领域的持续高度重视和大力支持。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等新兴应用领域的兴起,全球电子市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业,营业收入为20,458.3亿元,同比增长18.2%;其中,设计业营业收入为5,159亿元,同比增长19.6%;制造业营业收入为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试营业收入为2,763亿元,同比增长10.1%。根据海关统计,2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长4.6%;进口金额4,325.6亿美元,同比增长2.6%。2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长19.6%;进口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2022年半导体总产值全球销售额将达到6,149.4亿美元,同比增长8.8%,其中亚太地区(不含日本)将增长达8.4%。

根据Canalys的数据,2021年全球TWS耳机出货量2.94亿对,同比增长15.4%,单机平均售价提升至13.6美元,同比增长21%。根据Counterpoint公布的2021年全球智能手表的出货量情况,2021年全球智能手表出货量为1.27亿支,同比增长28.31%。根据Gartner的预测,2022年可穿戴设备将有15%的增速,相比2021年销售额为15亿美元,2022年销售额将会有39亿美元;其中智能手表销售额将达到313亿美元,同比增长21.3%。

(三) 技术门槛

集成电路设计行业是典型的系统密集型行业,并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计行业产品更新换代的创新能力和以前瞻的产品定义规划,才能从技术层面不断满足市场需求。同时公司产品的应用终端为消费类电子,产品具有更新速度快的特点。此外由于主要终端产品尚处快速发展阶段,技术标准尚在快速迭代的时期,在此背景下,公司持续保持技术的领先地位,必须持续高投入研发新技术、紧跟行业标准,以实现产品性能不断提高,满足客户的需求。同时持续保持高强度研发投入,也会提升公司技术水平和产品的竞争力,推动公司的进一步发展,为股东带来长期利益。

(四) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(五) 行业发展趋势及基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要构成包括设计、制造和封测环节,属于资本与技术密集型行业。我国自2000年起便开始实施相关政策文件,从产业规划、财税政策、资金引入等多个方面鼓励集成电路行业的发展,发展集成电路设计行业被写入国家五年发展规划及政府工作报告中,体现出国家对该领域的持续高度重视和大力支持。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等新兴应用领域的兴起,全球电子市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业,营业收入为20,458.3亿元,同比增长18.2%;其中,设计业营业收入为5,159亿元,同比增长19.6%;制造业营业收入为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试营业收入为2,763亿元,同比增长10.1%。根据海关统计,2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长4.6%;进口金额4,325.6亿美元,同比增长2.6%。2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长19.6%;进口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2022年半导体总产值全球销售额将达到6,149.4亿美元,同比增长8.8%,其中亚太地区(不含日本)将增长达8.4%。

根据Canalys的数据,2021年全球TWS耳机出货量2.94亿对,同比增长15.4%,单机平均售价提升至13.6美元,同比增长21%。根据Counterpoint公布的2021年全球智能手表的出货量情况,2021年全球智能手表出货量为1.27亿支,同比增长28.31%。根据Gartner的预测,2022年可穿戴设备将有15%的增速,相比2021年销售额为15亿美元,2022年销售额将会有39亿美元;其中智能手表销售额将达到313亿美元,同比增长21.3%。

(六) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(七) 行业发展趋势及基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要构成包括设计、制造和封测环节,属于资本与技术密集型行业。我国自2000年起便开始实施相关政策文件,从产业规划、财税政策、资金引入等多个方面鼓励集成电路行业的发展,发展集成电路设计行业被写入国家五年发展规划及政府工作报告中,体现出国家对该领域的持续高度重视和大力支持。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等新兴应用领域的兴起,全球电子市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业,营业收入为20,458.3亿元,同比增长18.2%;其中,设计业营业收入为5,159亿元,同比增长19.6%;制造业营业收入为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试营业收入为2,763亿元,同比增长10.1%。根据海关统计,2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长4.6%;进口金额4,325.6亿美元,同比增长2.6%。2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长19.6%;进口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2022年半导体总产值全球销售额将达到6,149.4亿美元,同比增长8.8%,其中亚太地区(不含日本)将增长达8.4%。

根据Canalys的数据,2021年全球TWS耳机出货量2.94亿对,同比增长15.4%,单机平均售价提升至13.6美元,同比增长21%。根据Counterpoint公布的2021年全球智能手表的出货量情况,2021年全球智能手表出货量为1.27亿支,同比增长28.31%。根据Gartner的预测,2022年可穿戴设备将有15%的增速,相比2021年销售额为15亿美元,2022年销售额将会有39亿美元;其中智能手表销售额将达到313亿美元,同比增长21.3%。

(八) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(九) 行业发展趋势及基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要构成包括设计、制造和封测环节,属于资本与技术密集型行业。我国自2000年起便开始实施相关政策文件,从产业规划、财税政策、资金引入等多个方面鼓励集成电路行业的发展,发展集成电路设计行业被写入国家五年发展规划及政府工作报告中,体现出国家对该领域的持续高度重视和大力支持。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等新兴应用领域的兴起,全球电子市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业,营业收入为20,458.3亿元,同比增长18.2%;其中,设计业营业收入为5,159亿元,同比增长19.6%;制造业营业收入为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试营业收入为2,763亿元,同比增长10.1%。根据海关统计,2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长4.6%;进口金额4,325.6亿美元,同比增长2.6%。2021年中国集成电路出口量3,107亿块,同比增长19.6%;进口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2022年半导体总产值全球销售额将达到6,149.4亿美元,同比增长8.8%,其中亚太地区(不含日本)将增长达8.4%。

根据Canalys的数据,2021年全球TWS耳机出货量2.94亿对,同比增长15.4%,单机平均售价提升至13.6美元,同比增长21%。根据Counterpoint公布的2021年全球智能手表的出货量情况,2021年全球智能手表出货量为1.27亿支,同比增长28.31%。根据Gartner的预测,2022年可穿戴设备将有15%的增速,相比2021年销售额为15亿美元,2022年销售额将会有39亿美元;其中智能手表销售额将达到313亿美元,同比增长21.3%。

(十) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十一) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十二) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十三) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十四) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十五) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十六) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十七) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后进行二次开发、设计或加工为模组PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂;经销商客户多为电子产品分销商。

(十八) 行业发展阶段

公司是专业的集成电路设计公司,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂完成,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司产品后